

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成30年5月10日(2018.5.10)

【公開番号】特開2016-200537(P2016-200537A)

【公開日】平成28年12月1日(2016.12.1)

【年通号数】公開・登録公報2016-066

【出願番号】特願2015-81884(P2015-81884)

【国際特許分類】

G 01 N 23/223 (2006.01)

【F I】

G 01 N 23/223

【手続補正書】

【提出日】平成30年3月26日(2018.3.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0026

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0026】

測定用基板12の結晶構造におけるカット面が分かっていない場合、まず、制御装置60が搬送装置50を制御して、カセット3に収納された測定用基板12を蛍光X線分析装置40の導入室のカセット47へ搬送させる。次に、制御装置60が搬送手段46および蛍光X線分析装置40を制御して、測定用基板12をrステージ48へ搬送させて載置し、測定用基板12を測定用基板12の中心軸心周りにステージによって時計方向に360°回転させながら1次X線43としてW-L1を照射させ、測定用基板12から発生する回折X線の強度を測定用基板12の回転角度と対応させた回折パターンを測定させて記憶する。そして、制御装置60が、記憶した回折パターン(図3)について、所定のX線強度比(W-L1/Si-K)以下のX線強度比が所定の角度範囲、例えば、3°～5°にわたって存在していると、この所定の角度範囲の中心角度位置を回折X線回避角度として記憶する。この回折X線回避角度は、例えば、75°、115°、185°、270°、350°などである。